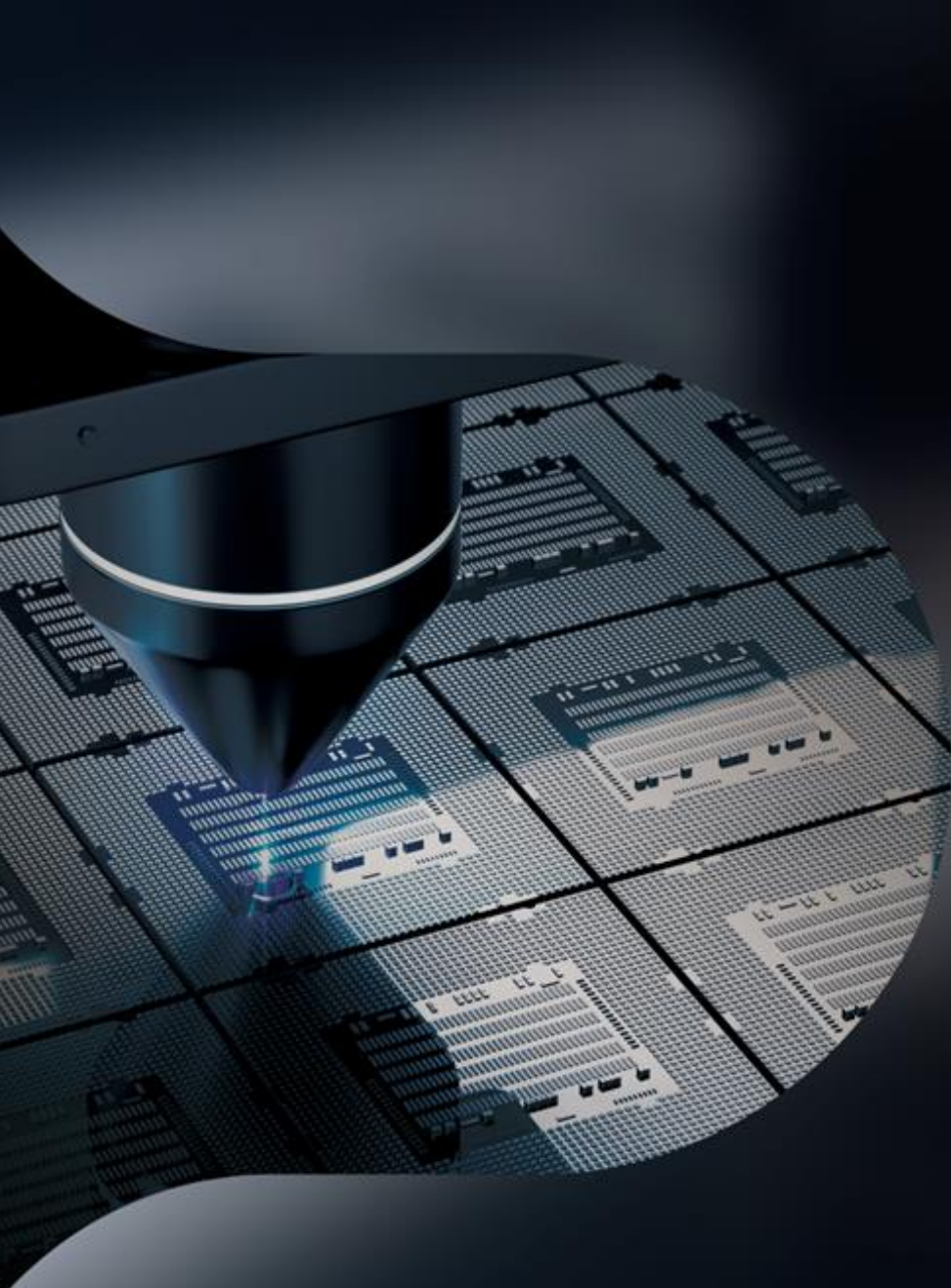




Innovative Printing & Coating Solution Provider for Manufacturing.

Investor Relations 2023



Disclaimer

본 자료는 기관투자자 및 일반투자자 등을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 엔젯 주식회사(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

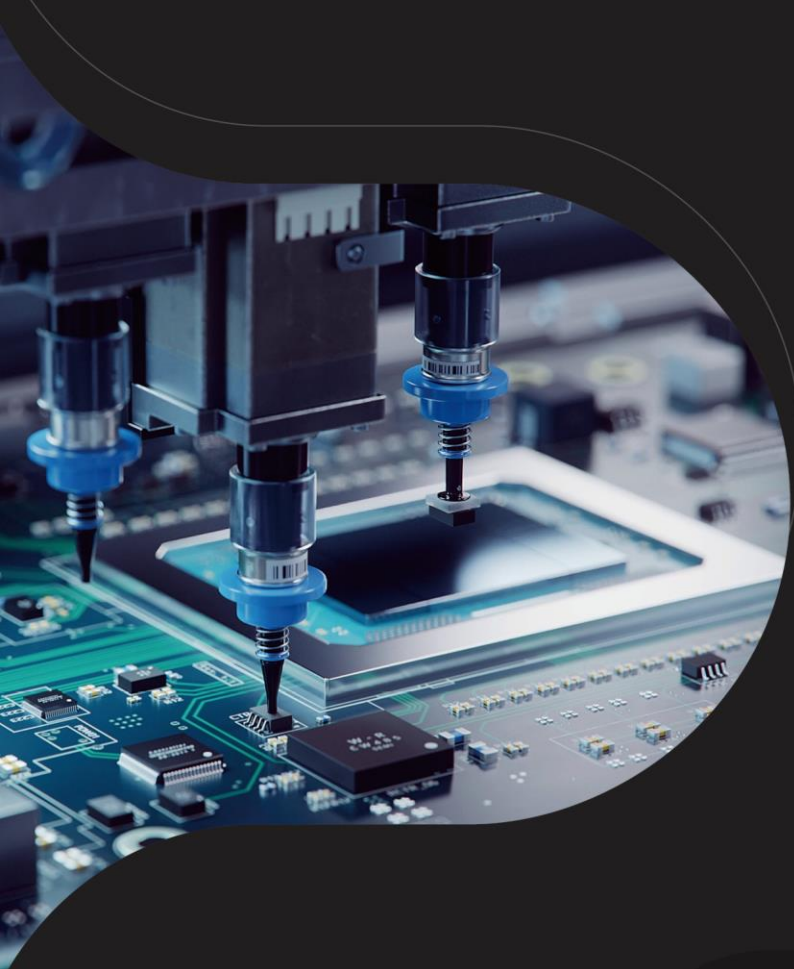


TABLE OF CONTENTS



Prologue

Chapter 01

About 엔젯

Chapter 02

Investment Highlights

Chapter 03

**The Next Innovator,
Printed Electronics Company**

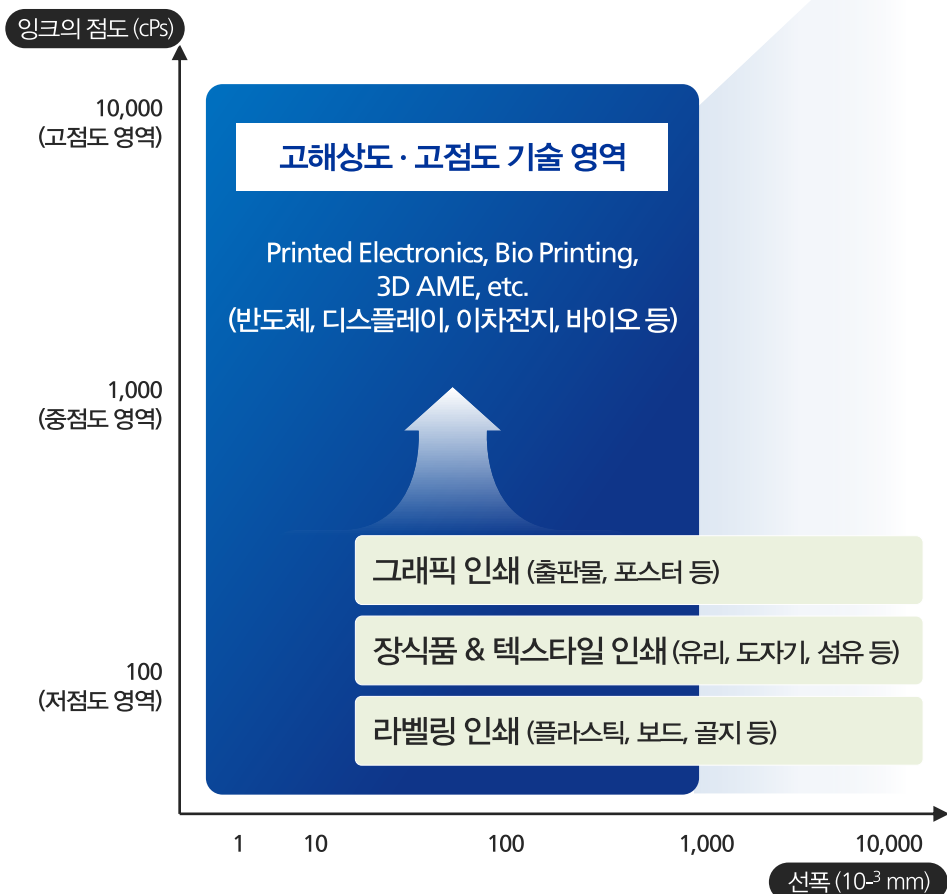
Chapter 04

Appendix

Innovative Printing & Coating
Solution Provider for Manufacturing.

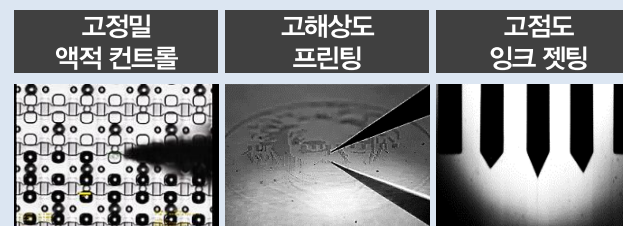
엔젯의 독보적 EHD 잉크젯 기술로 프린팅 산업의 새로운 부가가치 창출

프린팅 산업의 패러다임 변화 키워드 “고정밀도 · 고해상도 · 고점도”

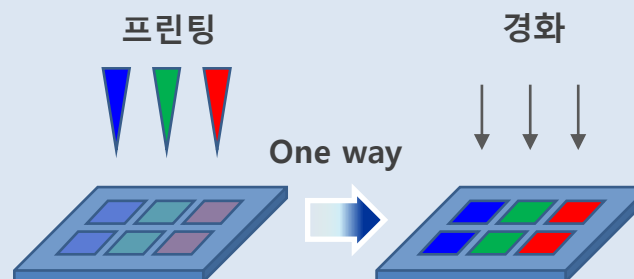


새로운 프린팅 산업 기술의 핵심

차별화된 초정밀 프린팅 기반의
인쇄전자기술 고도화 요구



Printed Electronics 공정 전환

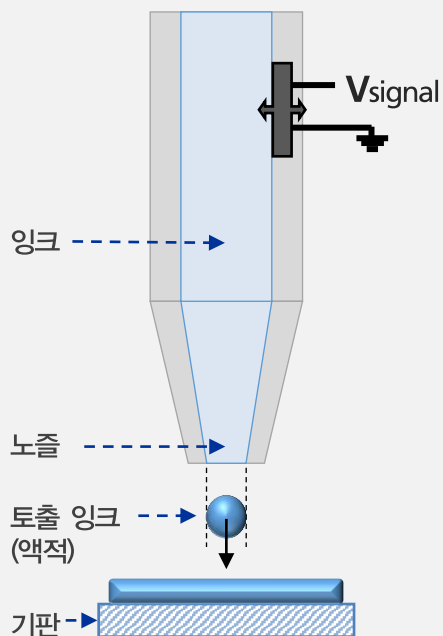


EHD 잉크젯 기술은 인쇄기술 중 가장 정밀하고, 다양한 점도의 잉크를 활용

EHD 잉크젯 기술: 정전기력을 이용하여 잉크를 제어하고 토출하는 초정밀 기술

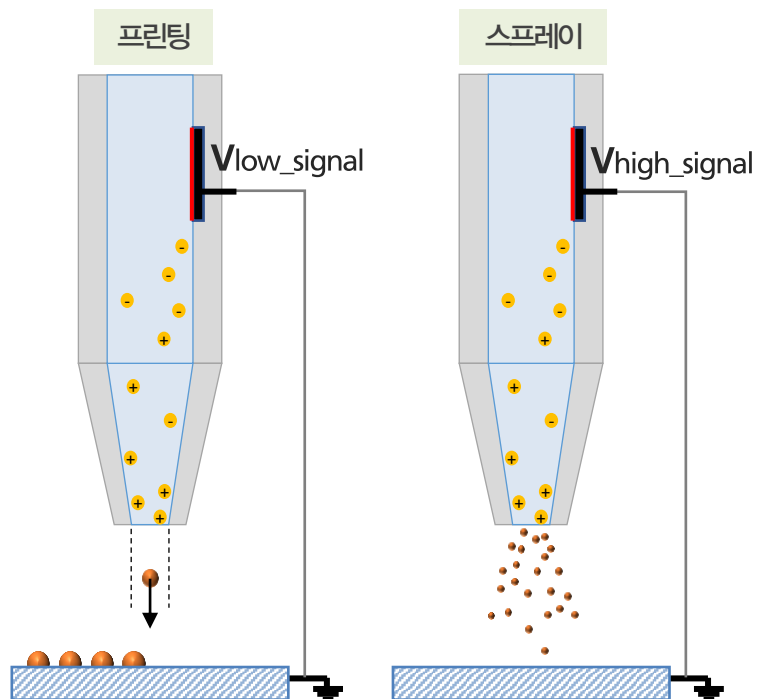


기존의 산업용 잉크젯 프린팅



- 생성되는 액적크기가 노즐의 크기에 제한되어 정밀도에 한계
- 내부에 생성되는 에너지 한계로 인해 고점도 용액 토출에 한계

엔젯(주) EHD 잉크젯 프린팅 기술 (독자개발 국산화)



잉크 $1\mu m$ (인쇄 해상도 by 엔젯) $<50\mu m$ (마이크로 LED TV) $50 - 100\mu m$ (사람 머리카락)		
기술 항목	기존 잉크젯 방식	EHD 잉크젯 방식
토출 방식	압전소자의 진동으로 잉크를 밀어냄	전기장 하에서 잉크를 당김
액적 크기	3-10 pl	$< 1\text{pl}$
사용 점도	30 cPs 이하	수 백 cPs 이상
대표 이미지		

세계 최초 EHD 잉크젯 기술 상용화 및 양산 적용

4차 산업혁명에 필요한
초미세 패터닝 / 초박막 코팅 공정 혁신 기업

1 μ m 급 초미세
패터닝
기술 상용화



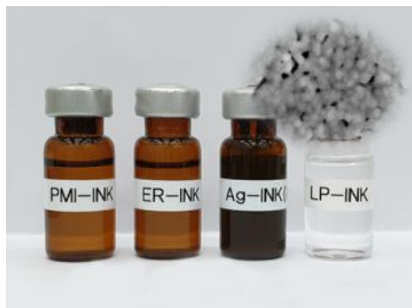
세계최초
양산 적용
글로벌시장 진입



경제적/친환경적
ESG 제조공정 혁신

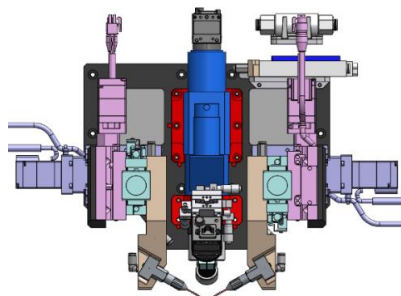
소재

잉크재료



부품

EHD Printing head 모듈



장비

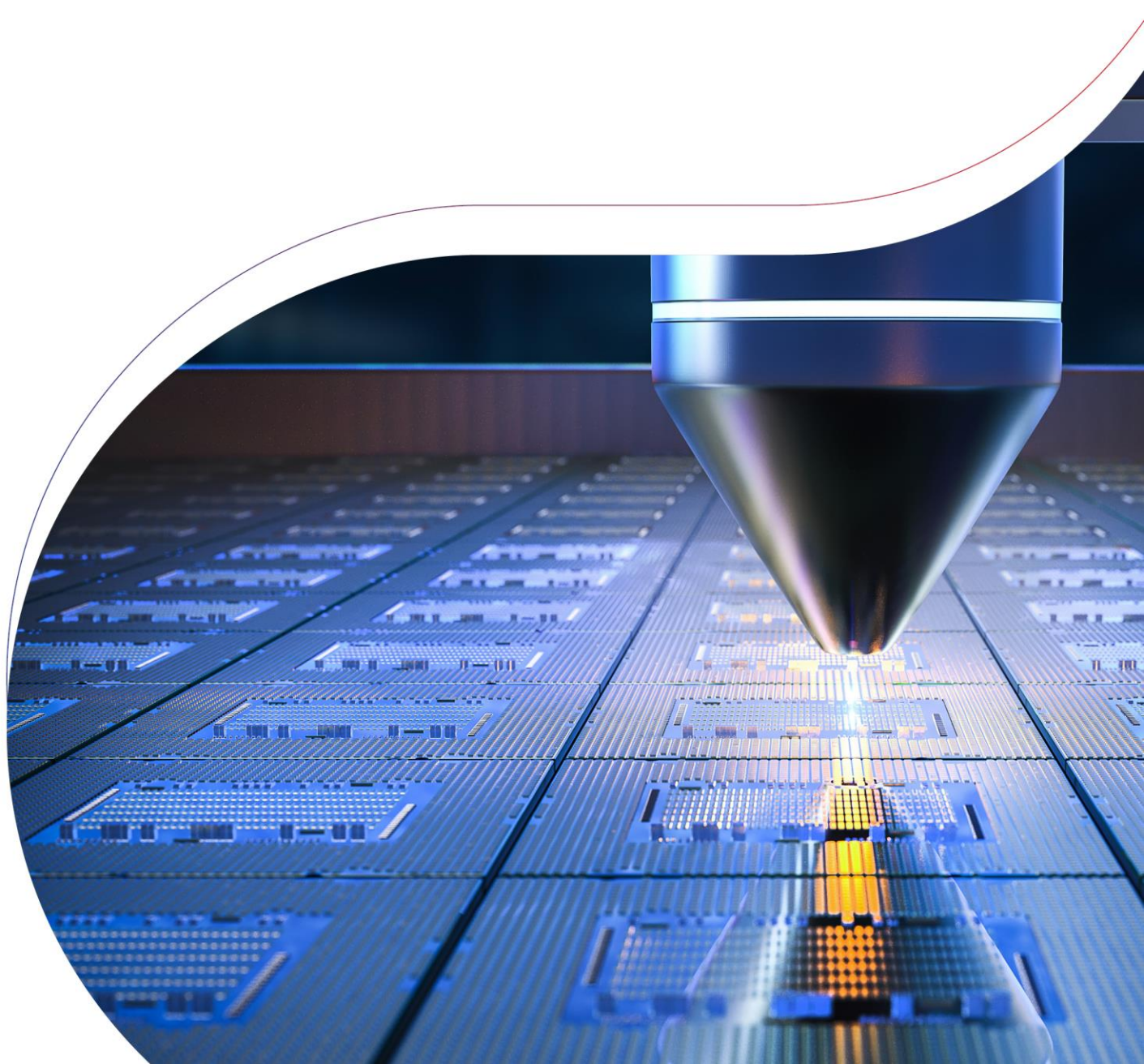
시스템 및 AI SW



01

About 엔젯

- 01. 엔젯의 성장 스토리
- 02. 주요 제품 소개
- 03. 높은 R&D역량



Innovative Printing & Coating
Solution Provider for Manufacturing.

원천기술 기반의 벤처에서 기술응용 확대를 통해 세계적인 **강소기업**으로 도약
글로벌 시장 다변화를 통해 **중견기업**으로 성장

매출액

영업이익

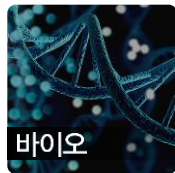
단위: 억 원



디스플레이

30
2019

-27



바이오

33
2020

-14



모바일

101
2021

18

216
2022(E)

53

448
2023(E)

182



멀티노즐

684
2024(E)

292



반도체

1,264
2025(E)

645

이외,
다양한 산업

Phase 1 (2009년~18년)

사업 기반 구축 및 양산화 준비

- 엔젯(주) 설립 (2009년)
- 기업부설연구소 설립
- NP-Standard 시스템 개발
- eNano 프린터용 소재 개발
- 장영실상 국무총리상 수상
- iEHD Coater 수출 / 양산
- 삼성전기 협력사 등록 (2017년)
→ iEHD Printer 납품
- 삼성전자 협력사 등록 (2017년)
→ iEHD Printer 납품/인증

Phase 2 (2019년~22년)

EHD 기반 본격 양산화

- iEHD Printer 납품
- 삼성디스플레이 협력사 등록 (2019년)
- 소재부품장비 강소기업100 선정
- AMAT 투자 유치 (2020년, 2021년)
- 삼성전자 iEHD 프린터 납품
- 대만 A사 iEHD 프린터 납품
- 삼성디스플레이 iEHD 프린터 납품
- 서울반도체 Micro LED 코터 납품

Phase 3 (2023년~26년)

산업별 응용 및 매출처 확대 다변화

장비

- 디스플레이 OLED TFT Repair, 측면배선 Chip Repair Solution
- 스마트폰 지문방지, 난반사 코팅, 폴더블/슬라이더블 폰 내구성 강화 코팅
- 자동차 CID 난반사 코팅
- 바이오센서 진단시약 균일 도포
- PCB PCB Repair
- 반도체 언더필

부품

- 디스플레이 OCR 코팅
- 반도체 TSV
- 자동차 디자인 코팅

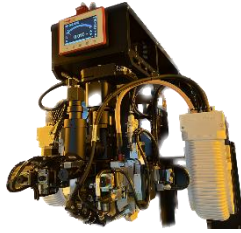
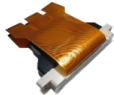
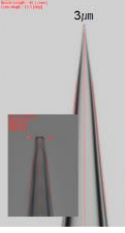
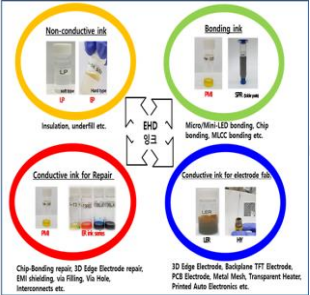
소재

- 디스플레이 OLED TFT Repair
- Micro LED 측면배선, 멀티전사

주요 제품 소개

디스플레이 산업을 중심으로 EHD 잉크젯 프린팅 솔루션 사업 다각화



	장비			부품	소재
대표 제품군	EHD 잉크젯 프린터			모듈	기능성 잉크재료
제품명	eNanoJet 프린터	eMicroJet 프린터	EHD 잉크젯 프린터	프린트 모듈	PMI, LP, EP
제품사진					
대표 제품군	디스펜서		EHD 스프레이 코터	EHD 프린트 헤드	프린트 노즐
제품명	EHD 디스펜서	eJet-Valve 디스펜서	eNanoJet 코터	ENJET-S,M,L Series	글라스 노즐 세라믹 노즐 & 샤프트
제품사진				싱글노즐  멀티노즐 	 
< ENJET Materials Productive line > 					

2022년 상반기
매출비중

EHD 잉크젯 프린팅 솔루션
(90.4%)

프린팅 솔루션
공급 증가



주기적으로 교체되는
부품과 소재 매출비중 확대 전망

EHD 코팅 솔루션
(6%)

기타
(3.6%)

03 높은 R&D역량

우수한 R&D전문 조직과 EHD핵심 기술특허 다수 보유



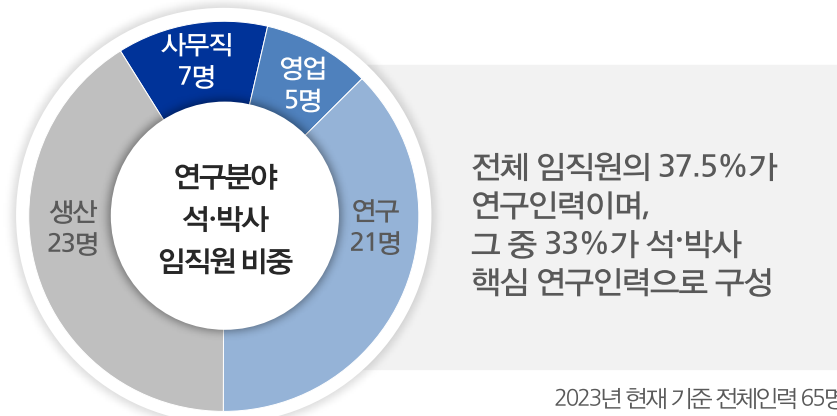
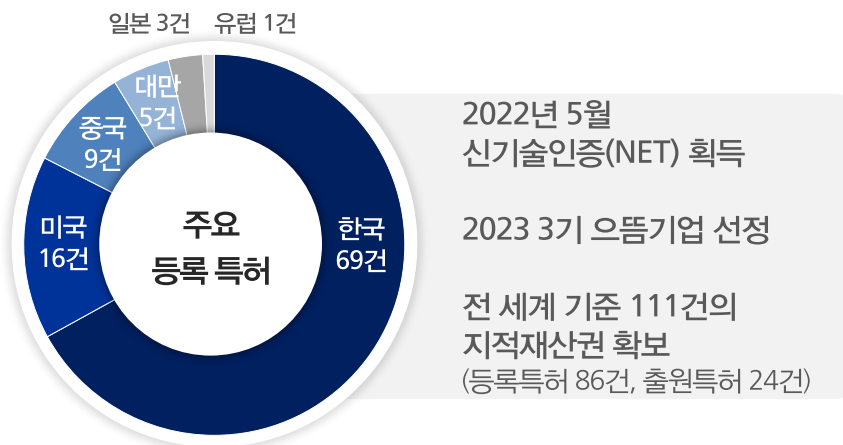
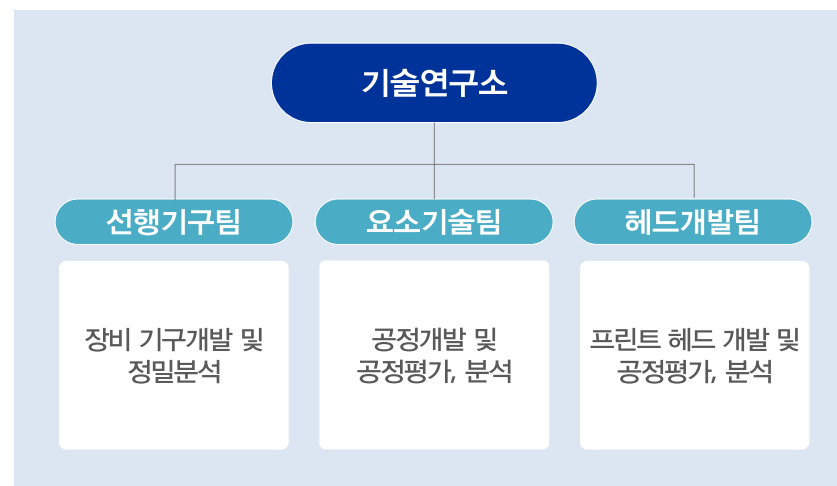
주요 인력 및 특허

변도영 CEO

- 성균관대학교 교수
- UC Berkeley 초빙교수
- Univ. of Penn 초빙교수
- 한국과학기술원 기계공학 박사
- 연구기술23년

정재우 CTO	부딕귀엔 시스템개발 총괄
성백훈 장비사업본부 총괄	손원일 재료사업본부 총괄

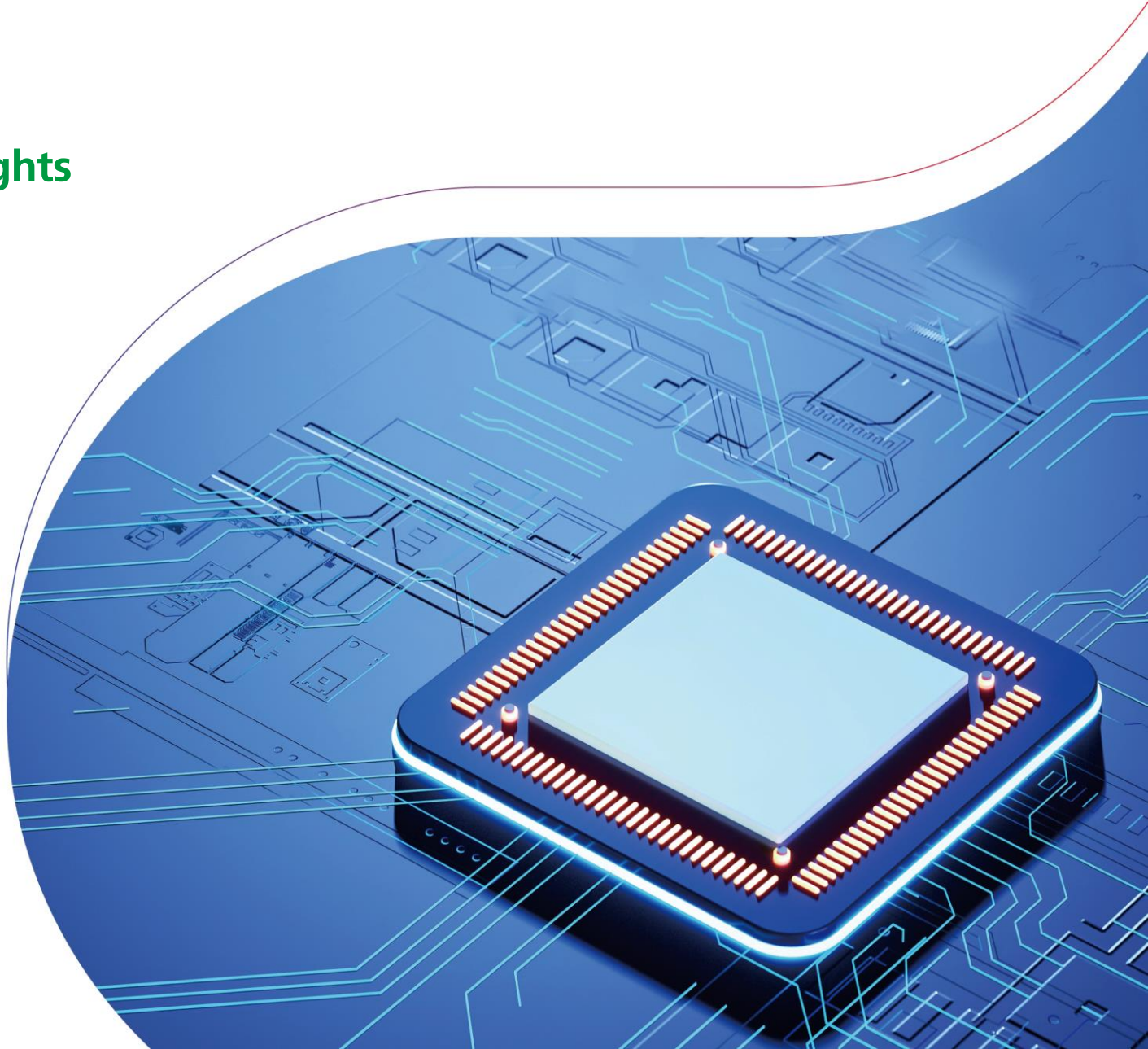
연구개발 조직도



02

Investment Highlights

- 01. Investment Highlights
- 02. 엔젯 EHD 기술 경쟁력
- 03. 원천 기술을 활용한 수익 기반 (1), (2)
- 04. EHD 기술의 폭넓은 확장성
- 05. 소부장 선순환 기반의 높은 이익률 지속
- 06. 시장 선점을 통한 진입장벽 구축



Innovative Printing & Coating
Solution Provider for Manufacturing.

프린팅 산업내 차별화된 경쟁력 보유



프린팅 산업이 주목하는
독점적인 원천
기술 경쟁력



다양한 4차 산업 공정
변화를 선도하는
사업성



시장 선점을 통한
진입장벽 구축

글로벌 시장조사기관
Yole Development 선정,
"차세대 프린팅 기술 장비 공급기업"

세계 유일의 EHD 양산기업

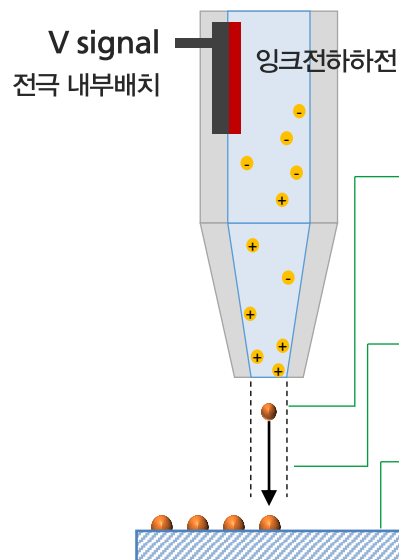


Electrohydrodynamic



출처: Equipment players by emerging printing techniques
(Emerging Printing Technologies 2019,
Yole Development, October 2019)

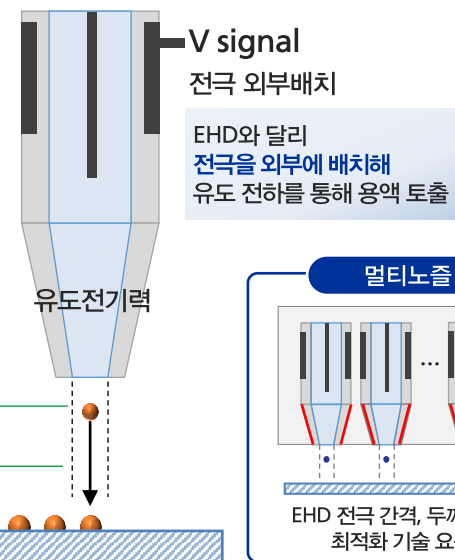
EHD 기술



특징

- 기존 잉크젯 기술 > 20 μm
- **엔젯의 EHD < 10 μm , 1 μm 의 패턴 형성가능**
- EHD 업체 중 유일하게 양산 경험 보유
- 다양한 특허와 Know-how로 진입장벽 형성

iEHD 기술로 확장



특징

양산성 향상을 위한 iEHD 원천 기술 확보

- 잉크와 전극 간 직접적인 접촉 → 잉크변성 Risk 존재
- 전극간 간섭으로 멀티노즐 개발 불가 → 낮은 생산성

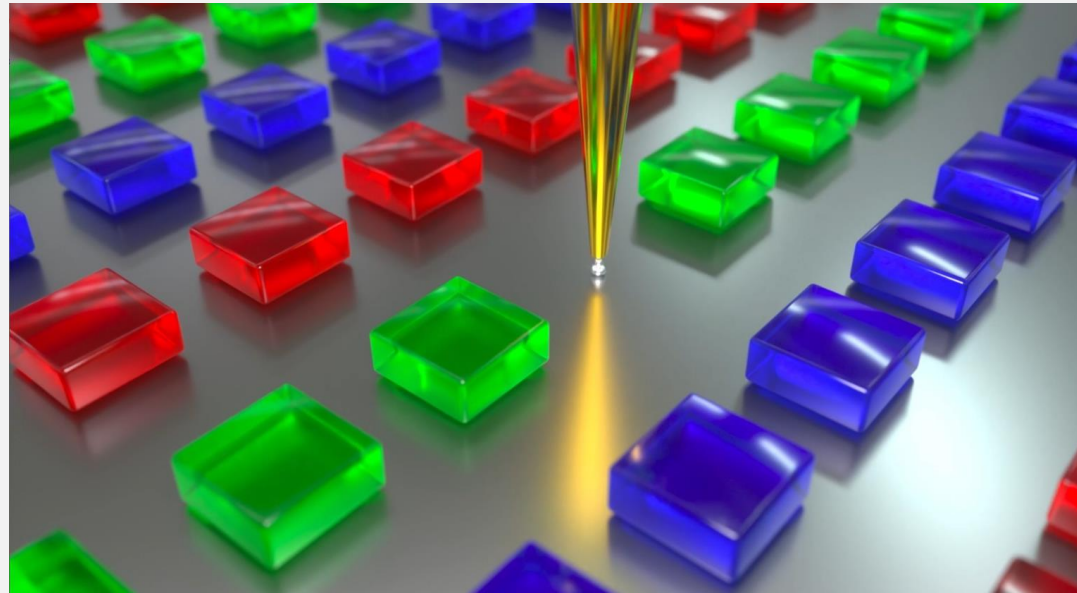
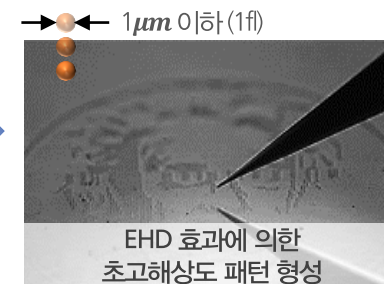
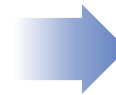
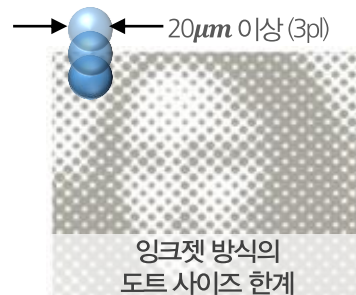


iEHD 기술: 멀티노즐 개발 및 잉크변성 free

고해상도 프린팅

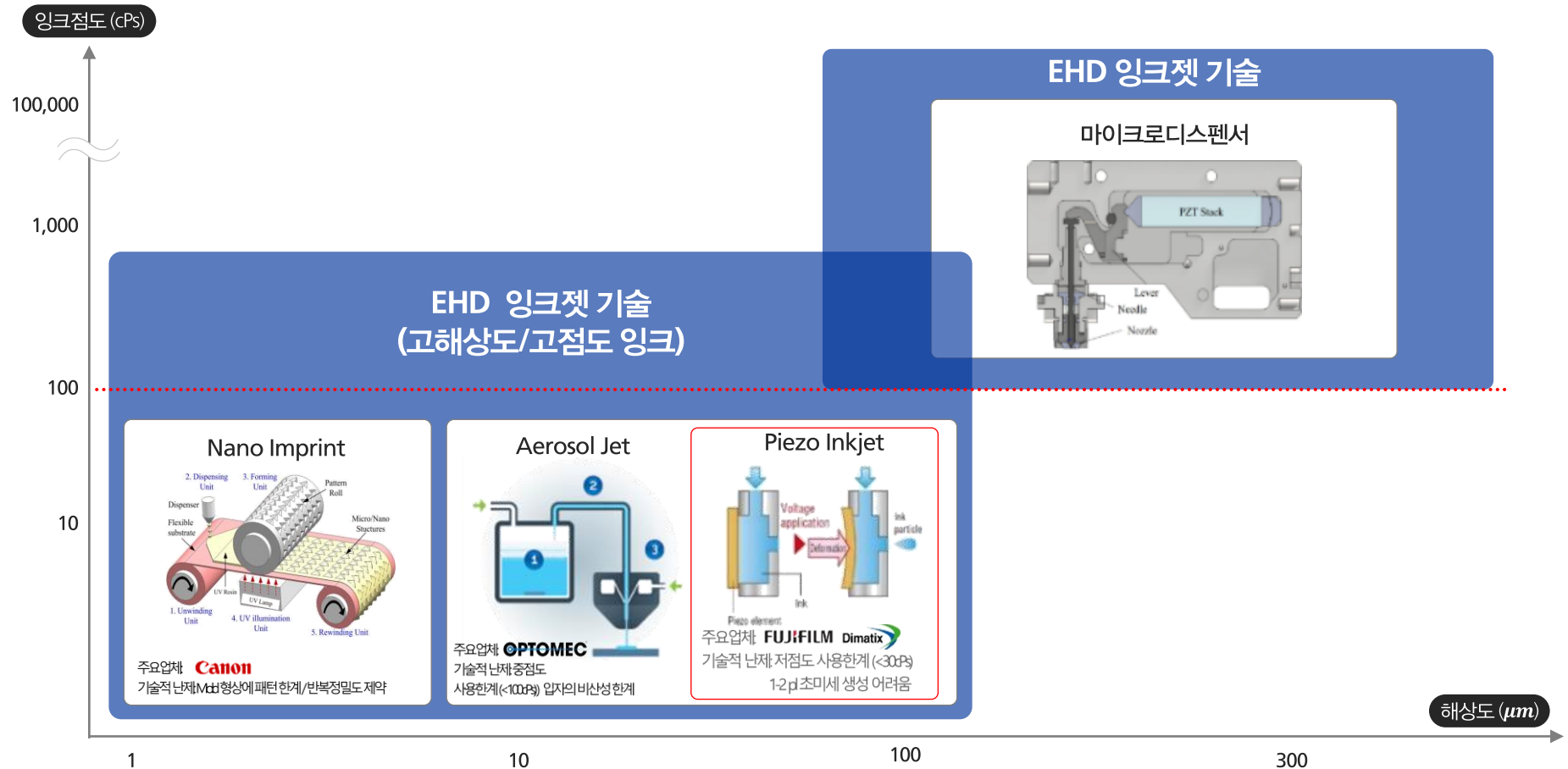
- 기존 잉크젯의 해상도 ($>50\mu\text{m}$) 한계를 극복
- 생성 액적 체적: 1 pl 이하 초미세 액적

※ pl: picoliter / fl: femtoliter



고점도 및 다양한 범위의 잉크 사용이 가능한 EHD 프린팅
(타 인쇄기술 대비 잉크 확장성이 용이한 장점)

고점도 프린팅



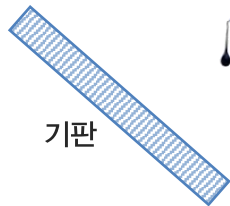
엔젯 EHD 기술 경쟁력 (3)

인쇄기술 중 가장 정밀하고, **액적컨트롤**이 우수한 EHD 잉크젯 기술
정전기력을 이용한 잉크 제어 기술이 핵심인 EHD (Electro-hydrodynamics) 공법



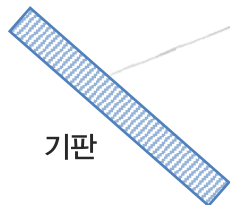
EHD에 의한 잉크 토출 현상

잉크 자유낙하



EHD 효과

잉크 제어로 직진성 확보
3차원 인쇄 효과적



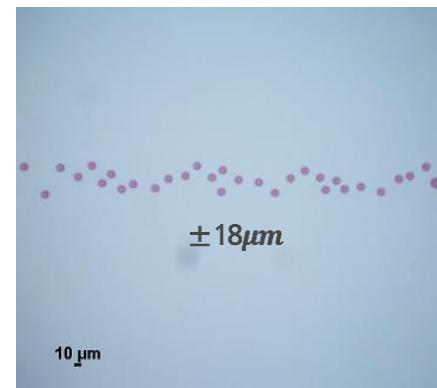
*EHD 패턴 두께 < 머리카락 두께

고정밀 프린팅

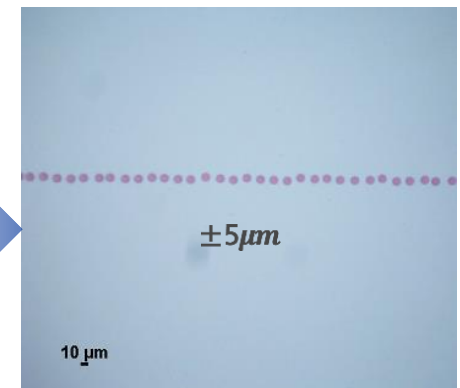
기존 잉크젯 대비 2배 이상 향상된 탄착정밀도 구현

- 2D/3D 표면 선택적 정밀 도포
- 전기장의 포커싱 효과 최적화
- 기판 소재 영향 최소화 가능 (Si, Metal, PET)

기존 잉크젯 패턴링
(오탄착 현상)



**EHD 효과에 의한
탄착 高 정밀도 향상**



엔젯(주) 수행결과

디스플레이 산업 내 다양한 분야에서 EHD 기술이 최초로 채택되기 시작

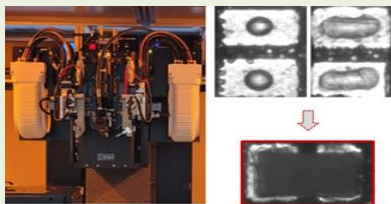
Micro LED - Chip Repair 복합기

Repair 복합기 기술

개발 배경

공정상 대량 전사된 LED칩 중
일부 불량칩 교체 기술 필요성 대두

엔젯의 초미세 패터닝 기술로
직접 50 μm 내 크기의 LED칩을
옮겨 넣는 Micro LED
칩 픽셀 실장 기술 개발



획기적인 불량률 감소

단가 감소

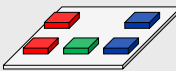
생산효율증대

기술 적용 프로세스

1. Chip 대량 전사 불량 Chip



2. 불량 Chip 제거



엔젯 기술

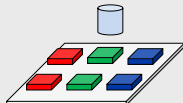
3. Bonding 잉크 인쇄 장비



4. 1 by 1 transfer 장비



5. 검사



6. Micro LED 패널 조립



스마트폰 디스플레이 - 빛샘방지 공정

빛샘방지 공정

개발 배경

홀(hole)방식 풀스크린 스마트폰은 디스플레이 빛이 카메라 모듈로
노출돼 카메라 화소가 제한

문제 해결을 위해 빛 차단 재료를 카메라 모듈의 3차원 형태로
홀 측면부에 도포 필요성 대두



엔젯의 초미세 패터닝 기술로
3차원 형태의 균일한 도포기술 구현

빛 간섭 문제 해결로 카메라 화소 제한 해소

글로벌 디스플레이 제조사 공정에 적용

03 원천 기술을 활용한 수익 기반 (2) - 바이오

바이오 산업 진출로 추가적인 미래 성장 동력 확보



적용 기술의 시장 배경 및 규모

국내외 바이오 업체와
전략적 협력체계 확보

U.S 바이오센서 시장

'21(E) ~ '28(E)
CAGR 7.6%

420억 달러
2028(E)

244억 달러
2021(E)

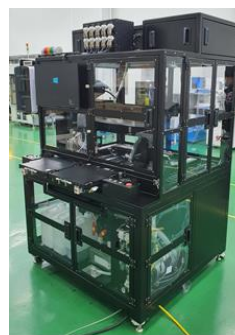
출처: grandviewresearch

바이오센서(진단키트)

기술 배경

- 기존 디스펜서 방식의 탄착 정밀도 및 정량 도포 한계
- 당뇨용 진단키트 용액의 정량 도포를 위한 공정 장비 개발
- EHD 기반의 젯-디스펜서 개발로 탄착 정확도와 액점 최소화

EHD 젯-디스펜서

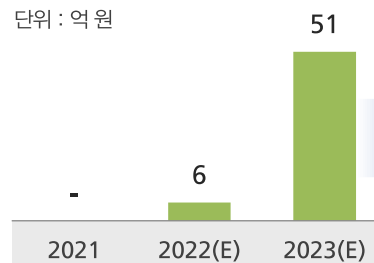


바이오 진단물질 도포 예시



바이오센서 매출 추이

단위 : 억 원



양산 장비 판매

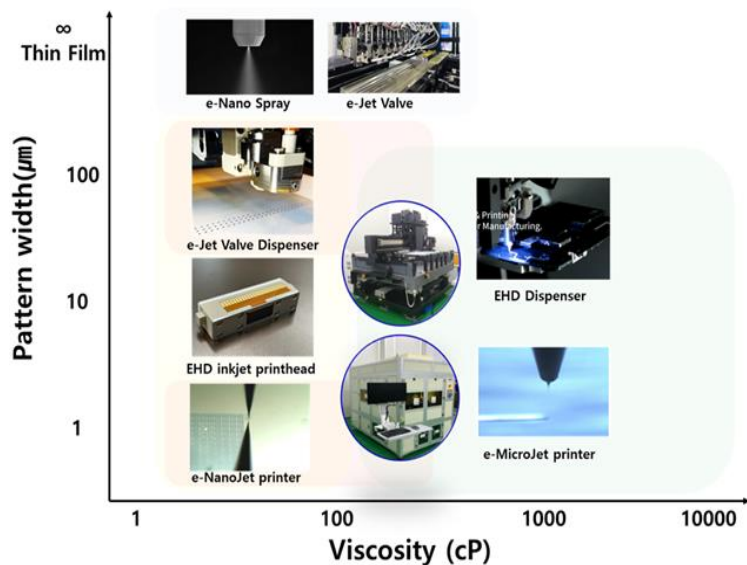
i.sens
아이센스社 外

다양한 산업과 제조공정에 적용할 수 있는 OSMU(One Source Multi Use) EHD 기술

엔젯의 EHD기술 사업 다각화 능력

EHD/IEHD기술을 바탕으로 수 μm 부터 수백 μm 의 패턴형성, 박막코팅, 다양한 점도의 잉크, 다양한 해상도 등 산업별로 요구되는 다양한 사양의 제품군 확보

인쇄 패턴폭과 점도 별 엔젯 제품군



주요 EHD 기술 적용 산업

Micro LED
OLED

디스플레이

패키징
전극

반도체

배터리 전극층

친환경 에너지

태양전지 전극층

태양광

진단키트
DNA

바이오

터치패널
FPCB

기타

i·sens

APPLIED
MATERIALS

SAMSUNG
삼성전자

SAMSUNG
삼성디스플레이

소부장 선순환 기반의 높은 이익률 지속

독보적인 EHD기술 + 시장 선점의 선순환 사이클 + 소모품 매출 증대를 통한 높은 이익률 달성



B2B 주력 **장비, 부품, 소재**
매출 선순환 사이클 확보



EHD 잉크젯 프린터

장비 운용에 필요한 부품 및 소모품
발생으로 교체 수요 지속



프린트 헤드



노즐



잉크

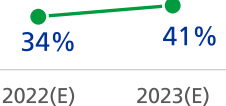
주기적인 부품 교체로 매출 지속



잉크젯 프린터 및
코터 장비의 지속 판매



장비 납품에 따른 부품 및
소모품 추가 발생 예정



소모품의 종속성으로 높은
영업이익률 달성

라인증설 및 장비 셋업 후
지속적인 소모품 교체 발생

256 노즐 개발 완료 및 상용화로
부품 소재 부문의 지속적인 매출
발생

독보적인 기술을 기반으로 주요 업체와의 개발 네트워크를 통해 산업 내 시장선점 Only & First Mover

긴 개발기간과 비용이 소요되는
기술 및 제품의 최초 개발

최초 양산을 통한 레퍼런스
확보로 시장선점

선점의 효과로
강력한 진입장벽 구축

시장 선점으로
국내외 글로벌
기업과의 협력 공고화

MEMS 공정:
5년 이상의 긴 연구기간 및
500억 이상의 비용 소요

AMAT, 삼성전자,
삼성디스플레이 등 글로벌
기업과의 공정 공동개발 및
최초 양산화

원천기술 특허 및 공정
노하우로 진입장벽 형성

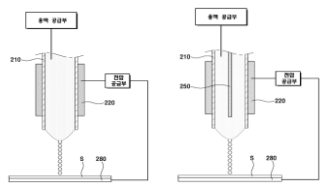
시장 선점

높은 기술 난이도

최초 양산

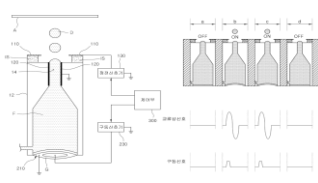
특허 및 공정 노하우

싱글노즐 기술특허



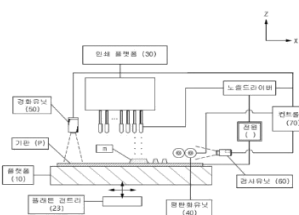
유도전기수력학 젯 프린팅 장치
특허(10-2146196)

멀티노즐 기술특허



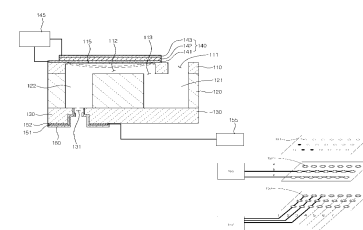
액적분사장치
특허(10-0917279)

EHD 3D 기술특허



물체 적층 조형시스템
특허(10-2022-0030264)

멀티노즐 프린thead

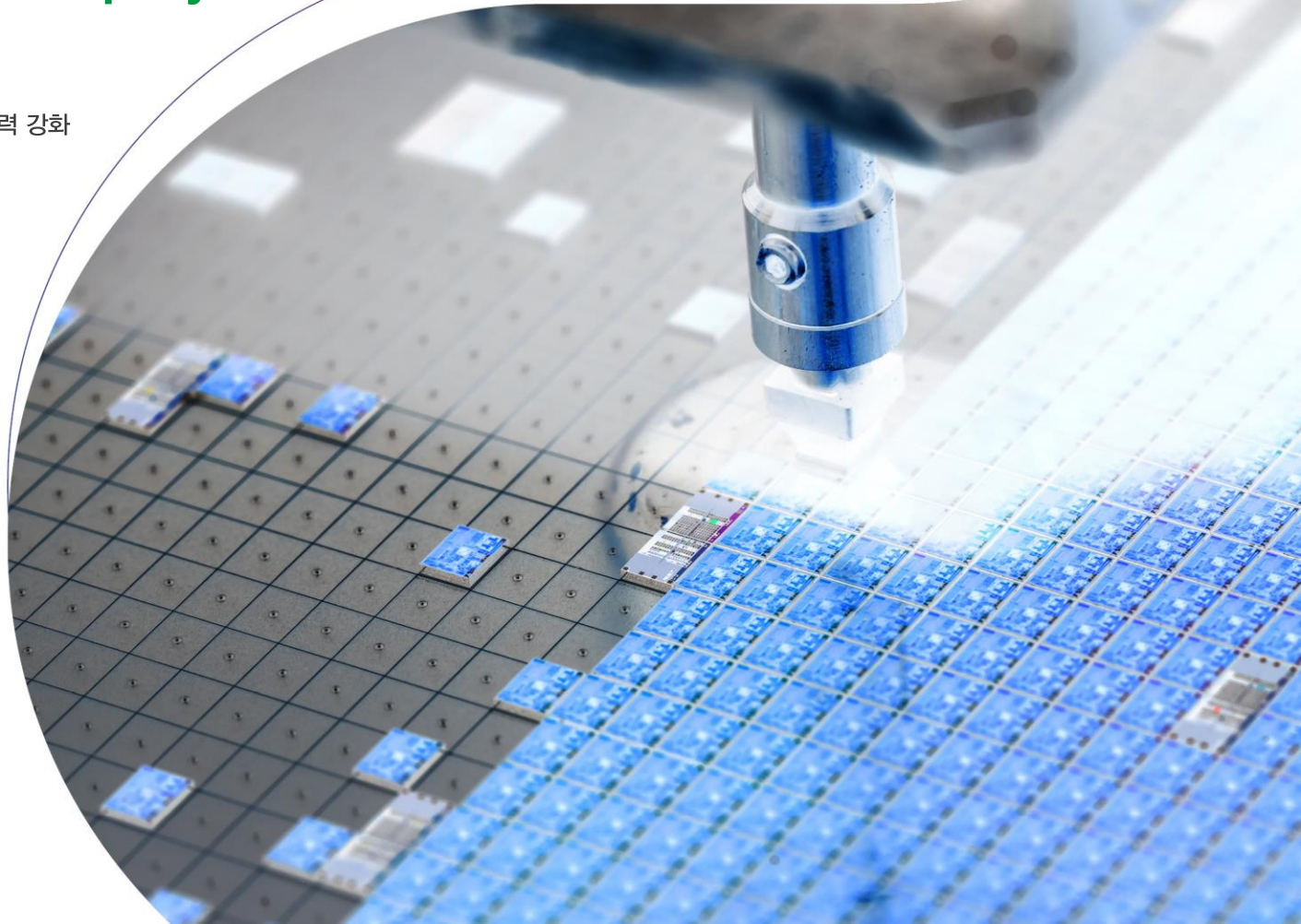


잉크젯 프린thead
특허(10-2022-0029786)

03

The Next Innovator, Printed Electronics Company

- 01. 적용 산업의 시장 확대
- 02. 응용 공정 분야의 확대 (1), (2), (3)
- 03. EHD 전용 잉크 기술 확보로 사업경쟁력 강화
- 04. EHD 잉크젯 프린트 헤드 개발 로드맵
- 05. 글로벌 진출 본격화



Innovative Printing & Coating
Solution Provider for Manufacturing.

적용 산업의 시장 확대

Printed Electronics 시장 확대 및 전방 시장의 수요로 고성장세 예상
경제적/친환경적 ESG 제조공정 혁신 요구에 부응(필름대체 공정)



디스플레이

반도체

적용 기술의 시장 규모

OCR 코팅 시장

20억 달러
2025(E)

'20(E) ~ '25(E)
CAGR 8.6%

현재

출처: Allied Market Research

잉크젯 프린트헤드 시장 (산업용 프린팅)

\$1,347M
2024(E)

'18 ~ '24(E)
CAGR 10%

\$762M
2018

출처: Yole_Report 2019

측면배선 기술

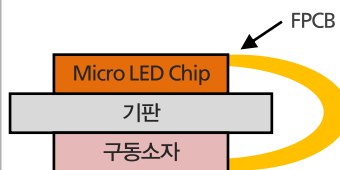
대형 및 베젤리스 디스플레이 구현을 위해
패널간 간격 최소화 기술 필요

엔젯(주)의 초미세 패터닝 기술로
디스플레이 측면에 초정밀 프린팅 기술개발

“새로운 폼팩터로의 디스플레이 제품 확장”

기술 적용 전후 비교

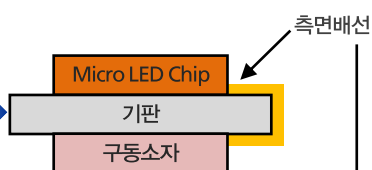
적용 전



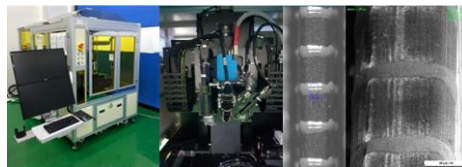
하부의 구동소자와 Micro LED chip을
FPCB를 Bending해 연결

FPCB의 Bending 곡률로
패널 조립간 간격이 벌어져
Dead Space 존재

적용 후



초정밀, 파인피치의 3차원
배선 구현기술을 통해
Dead Space 최소화



필름 대체공정 기술

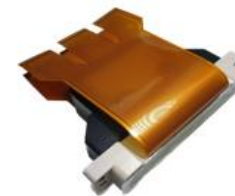
디스플레이 패널 생산 공정상 사용되는 필름으로
환경 오염, 제조 원가 부담 등의 문제 대두

필름을 용액 공정으로 대체하기 위한
특수한 인쇄 공법 필요

엔젯(주)의 EHD 잉크젯 프린팅 기술로
**“디스플레이 공정 내 필름을 용액 공정으로”
대체가능한 고점도/고정밀 인쇄 기술 구현**

필름 대체공정 핵심부품

EHD Inkjet Print head



두께 25um~300um 정도의
고점도 인쇄 구현

고정밀 인쇄 기능

PCB REPAIR기술

인쇄회로기판 PCB는 공정상 인쇄 후 불량 발생시 폐기

IT산업의 발달로 인한 급격한 PCB 수요증가로
불량 PCB를 활용할 REPAIR 작업 필요

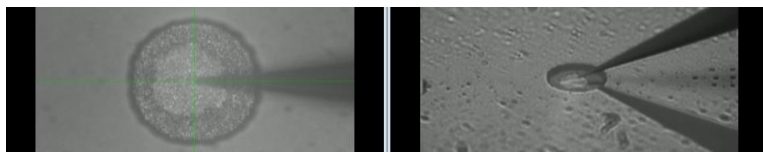
엔젯(주)의 EHD 잉크젯 프린팅 기반 PCB REPAIR기술로
“높은 수율 확보와 불량 PCB 재사용 환경 구현”

기술 적용 사례

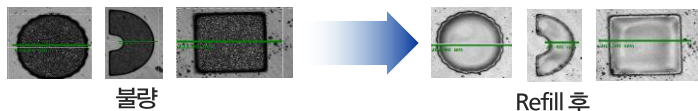
기술개발을 완료해 글로벌 고객사에 적용

Chipping 불량

EHD Inkjet Filling



형상/크기 Repair 결과



폴더블폰 기능성 코팅기술

폴더블 디스플레이의 초박막 Glass는
낮은 강도로 보호 필름을 부착해 생산

보호필름으로 인한 접합부 주름 및 감도저하 문제로
기능성 코팅 공법 필요

엔젯(주)의 EHD 코팅 기술로
“폴더블 UTG 취약성을 보완, 제품의 강도 향상”

기술 적용 사례

글로벌 스마트폰 제조사와 공동개발 진행



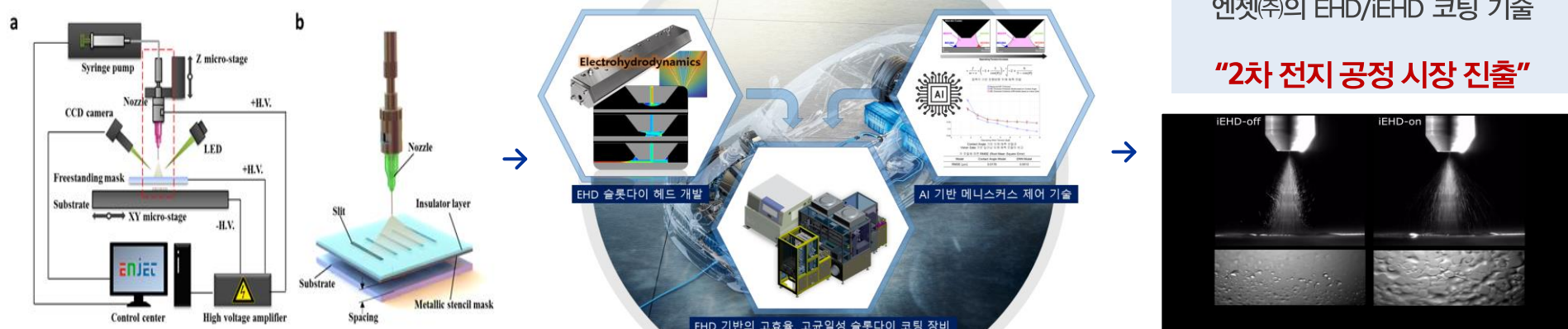
고점도 용액공정을 이용, 100um이상의 글라스가 접히는 부분에
적용가능한 기능성 코팅 기법 개발

2023년 또는 2024년부터 장비납품 예상(변동 가능)

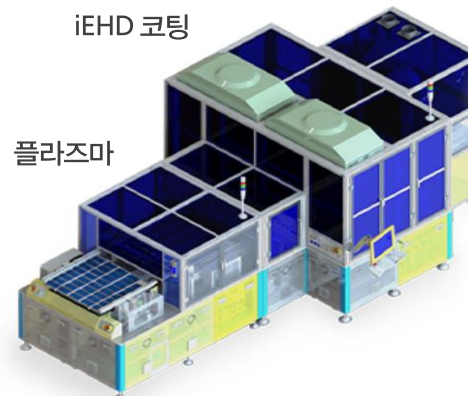
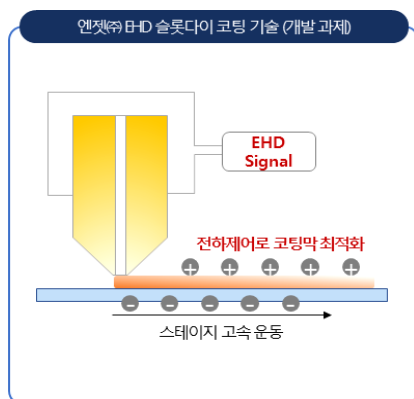
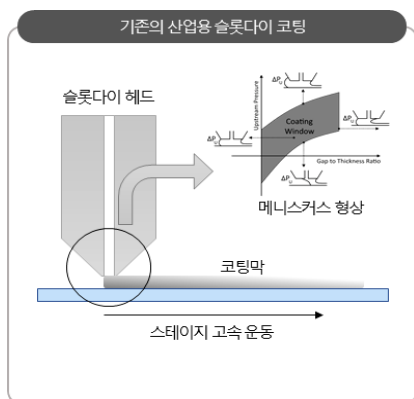
초정밀 코팅 기술을 이용한 2차 전지 공정 시장으로의 본격적인 진출

이차전지 슬롯다이, 이차전지 연료전지 촉매

코팅 : 정밀도가 높은 코팅막 구현 (스프레이와 마스크 기법을 이용한 상압 증착 패턴기술)



슬롯다이 기존 기술 비교, iEHD 초박막 코팅 우수성



건조

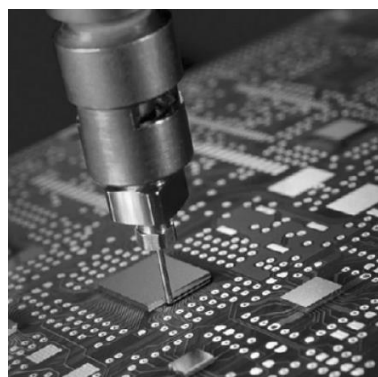
EHD/iEHD 기술을
이용한 슬롯다이 코팅,
연료전지 촉매 코팅

“코팅재료 절감,
품질개선,
표면 마모의
불량을 저감”

[엔젯 이차전지용 코터]

반도체 언더필 공정

언더필: 패키지 밑의 절연 수지 이용하여 완벽히 메우는 공법



현재 디스펜싱과 Jet-valve
싱글 노즐로
언더필 공정을 진행 중



반도체 소형화로 도포량과
고점도 소재로 인한
기존 잉크젯 프린트의
기술한계 발생

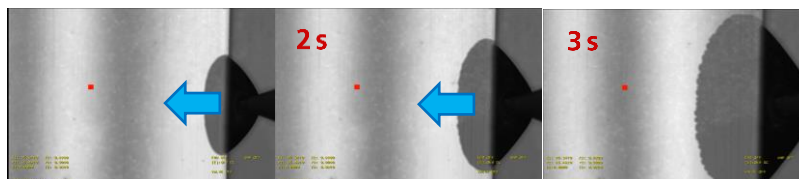


엔젯(주)의 EHD 잉크젯 프린팅 기술은
전기장을 이용해 액적제어 가능

**“반도체 칩의 측면부와 하부로
고속 정밀 인쇄 구현”**

기술적용 전후 비교

기존
Conventional
Dispensing method



엔젯 EHD
dispensing method



EHD 멀티노즐을 이용,
싱글노즐 대비 약 10배 이상 생산성 향상



“제조 원가절감 실현”

03

EHD 전용 잉크 기술 확보로 사업경쟁력 강화

EHD/IEHD 기술에 최적화된 기능성 잉크 공급을 통한 Lock-in 효과
(고객 맞춤형 잉크 제조 시설 확보)



기존 잉크는 전기화학적 반응이 야기되어 불량 발생 가능성 높음
→ iEHD 잉크젯 제조에 최적화된 기능성 잉크 독자 개발

전용
잉크 개발

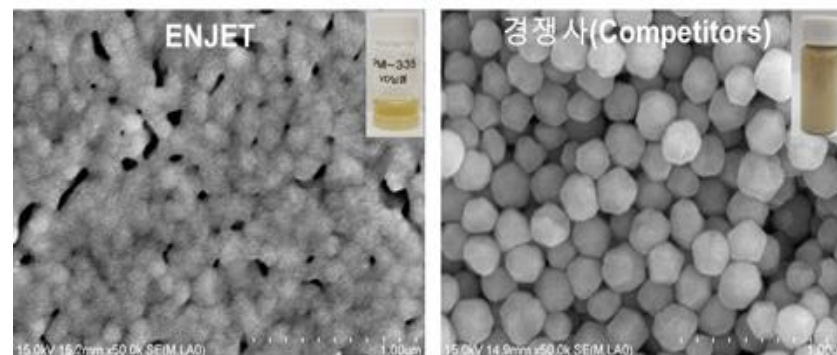


각 공정기술에 최적화를 위한
전용 재료기술 개발 및 확보

본딩용 잉크 : PMI

절연잉크 : LP

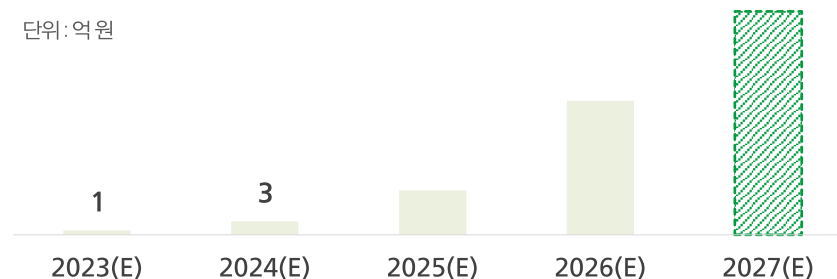
전극형성용 무입자 타입 잉크 : LER



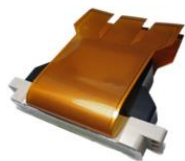
기능성 재료 변경점의 최소화 / 젯팅 대응 능력 확대

잉크 매출 추이

단위: 억 원



기술 현황

멀티 노즐
(높은 생산성)높은 비용, 장기간
개발 시간으로
진입장벽 구축16노즐
(현재)512노즐
(2025년)노즐
젯팅
장면

1N

2N

3N

4N

5N

6N

7N

8N

9N

10N

11N

12N

13N

14N

15N

16N

양산화 전략

2022년
16노즐2023년
256노즐2025년
512노즐양산 전
평가 중1차 설계 완료,
후공정 및
패키징 진행공정설계
및 제작

2025년까지 250억 원 자금 사용 계획

공정 대체로 인한 기대효과

- 1 생산속도: 공정 단순화로 생산속도 증가
- 2 투자비용 축소: 공정 대체로 인한 초기 투자비용 감소
- 3 친환경: 불필요한 폐기물 배출 최소화

프린팅 산업의 선도기업

Printed Electronics



전략적 협업

지분투자: 글로벌 반도체 장비기업인
AMAT와 전략적 협업 체계 구축



글로벌 고객사 니즈에 맞는 응용 개발 확대

측면배선, 기능성 코팅 등
응용 기술 확대



글로벌 재료 회사 협력 체계 구축

기능성 잉크 자체 개발 및 협력



해외 영업망 구축

- 현지법인 설립, JV 설립 추진
- 미국, 유럽, 중국 등 해외 시장 다변화

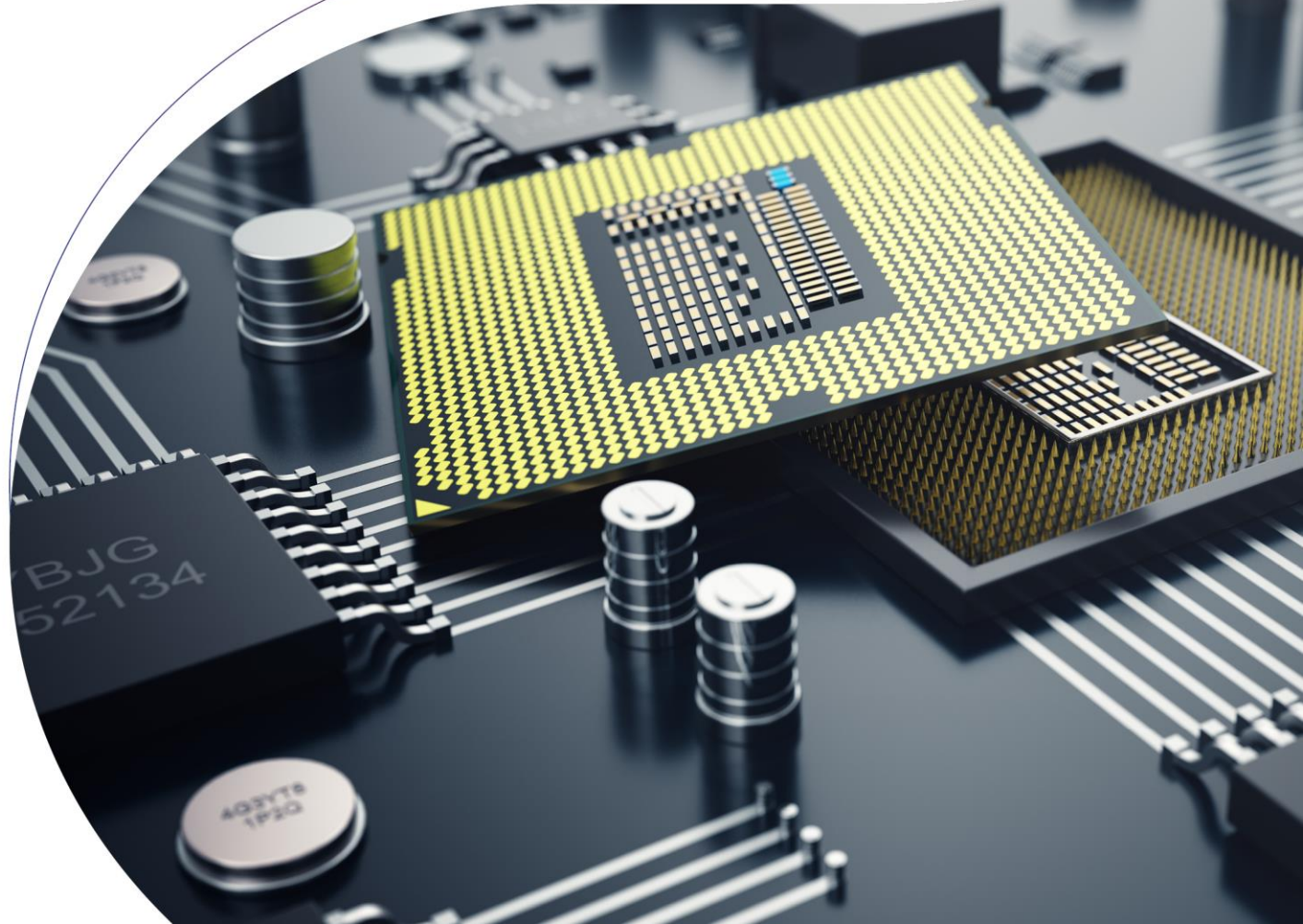


04

Appendix

01. 기업개요

02. 요약 재무제표



Innovative Printing & Coating
Solution Provider for Manufacturing.

01 기업개요



회사 현황

회사명	엔젯 주식회사
대표이사	변 도 영
설립일	2009년 09월 09일
자본금	52.5억 원
임직원수	73명
주력 제품	EHD 잉크젯 프린터, EHD 코터
주소	경기도 수원시 권선구 산업로 92번길 45 (고색동, ENJET)

CEO

변 도 영 CEO

주요 이력

- 現) 엔젯 대표이사
- 現) 성균관대학교 교수
- 한국과학기술원 박사 졸업

주요 수상

- 기술독립 중소벤처기업부 장관상
- 나노코리아 산업통상자원부장관 우수상
- IR52 장영실상 국무총리상

본사 전경

